



京セラ株式会社

CORPORATE PROFILE

2024/02

- ◆ What's Kyocera? ～会社概要と京セラの強み～ [p. 3](#)

京セラ初心者の方へ

- ◆ 京セラの重点市場 [p.11](#)

注目
情報

- ◆ 京セラの福利厚生 [p. 25](#)

高専生注目度★★★★ プライベートも充実させたい方必見！

- ◆ 京セラ鹿児島島川内工場について [p. 30](#)

限定
公開

- ◆ 高専卒先輩社員(川内工場)の業務とキャリア [p.41](#)

本資料限定情報！高専卒社員の1日から20年間までが分かる！

- ◆ 選考情報 [p.48](#)

A scenic view of a city at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. In the foreground, there are dark, silhouetted trees. In the middle ground, a city with many buildings is visible. On the right side, a traditional Japanese pagoda with multiple tiers and a spire is prominent. The sky is a mix of orange, yellow, and blue.

What's KYOCERA?

会社概要～京セラとは～

設立	1959年4月1日
創業者	稲盛 和夫
代表取締役社長	谷本 秀夫
資本金	1,157億300万円
連結売上高	2兆253億3,200万円
グループ会社数	298社(京セラ(株)を含む)
グループ従業員数	81,209名

※2023年3月31日現在



名誉会長
稲盛 和夫



代表取締役社長
谷本 秀夫



全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、

To provide opportunities for the material and intellectual growth of all our employees,

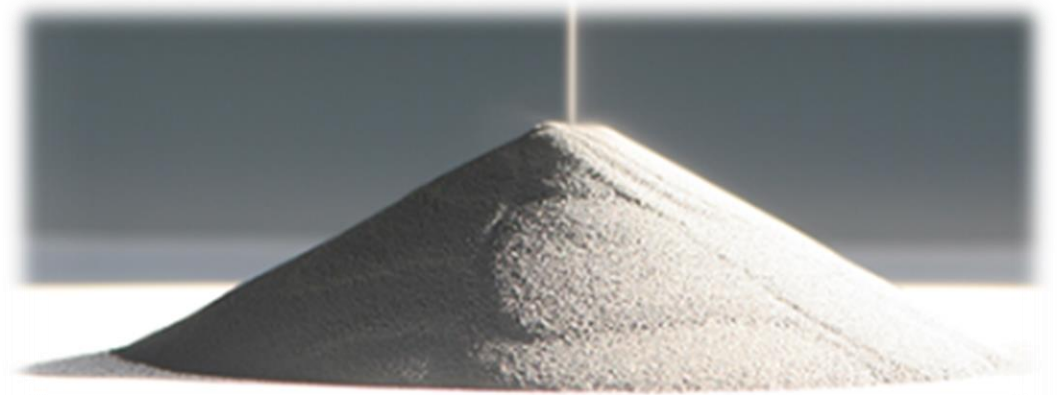
人類、社会の進歩発展に貢献すること。

and through our joint efforts, contribute to the advancement of society and humankind.

BORN IN 1959


独自のファインセラミック技術

人工的に精製・合成された高純度な原料を使用し、厳格に管理された成形、超高温の焼成などのプロセスから生み出される優れた材料特性をもつ陶磁器の一種。



 **機械的特性**


- ✓ 硬度
- ✓ 剛性
- ✓ 靱性 など

 **熱的特性**

- ✓ 耐熱性
- ✓ 熱膨張
- ✓ 熱伝導率 など

 **電気的特性**

- ✓ 絶縁性
- ✓ 導電性
- ✓ 誘電性 など

 **化学的特性**

- ✓ 耐薬品性
- ✓ 生体適合性 など

多角的な事業展開

③ソリューション



複合機・プリンタ



インクジェットプリントヘッド



機械工具



ディスプレイ



スマートフォン



太陽光発電システム

③52.8%

①29.2%

2023年3月期 連結売上高

2兆253億円

②18.7%

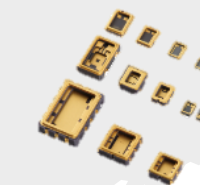
①コアコンポーネント



半導体製造装置用部品



車載用カメラモジュール



セラミックパッケージ



有機多層基板



人工股関節



セラミックキッチン用品

②電子部品



7 コンデンサ



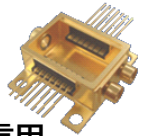
水晶デバイス



SAWデバイス

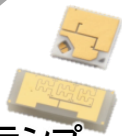
世界に誇るトップシェアの製品

光通信機器



光通信用
パッケージ

自動車

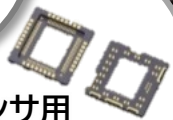


ヘッドランプ
LED用パッケージ

スマートフォン



電子部品用
パッケージ



イメージセンサ用
パッケージ

世界シェア

No.1※

(※セラミックパッケージの主要4市場(SMD(SAW/水晶)、イメージセンサ、車載LED、光通信)で約70%(2022年京セラ調べ)※

グローバル展開

事業展開国数(2023年時点)

約**30**か国



海外グループ会社数(2023年時点)

約**300**社



全世界で働く従業員数(2023年時点)

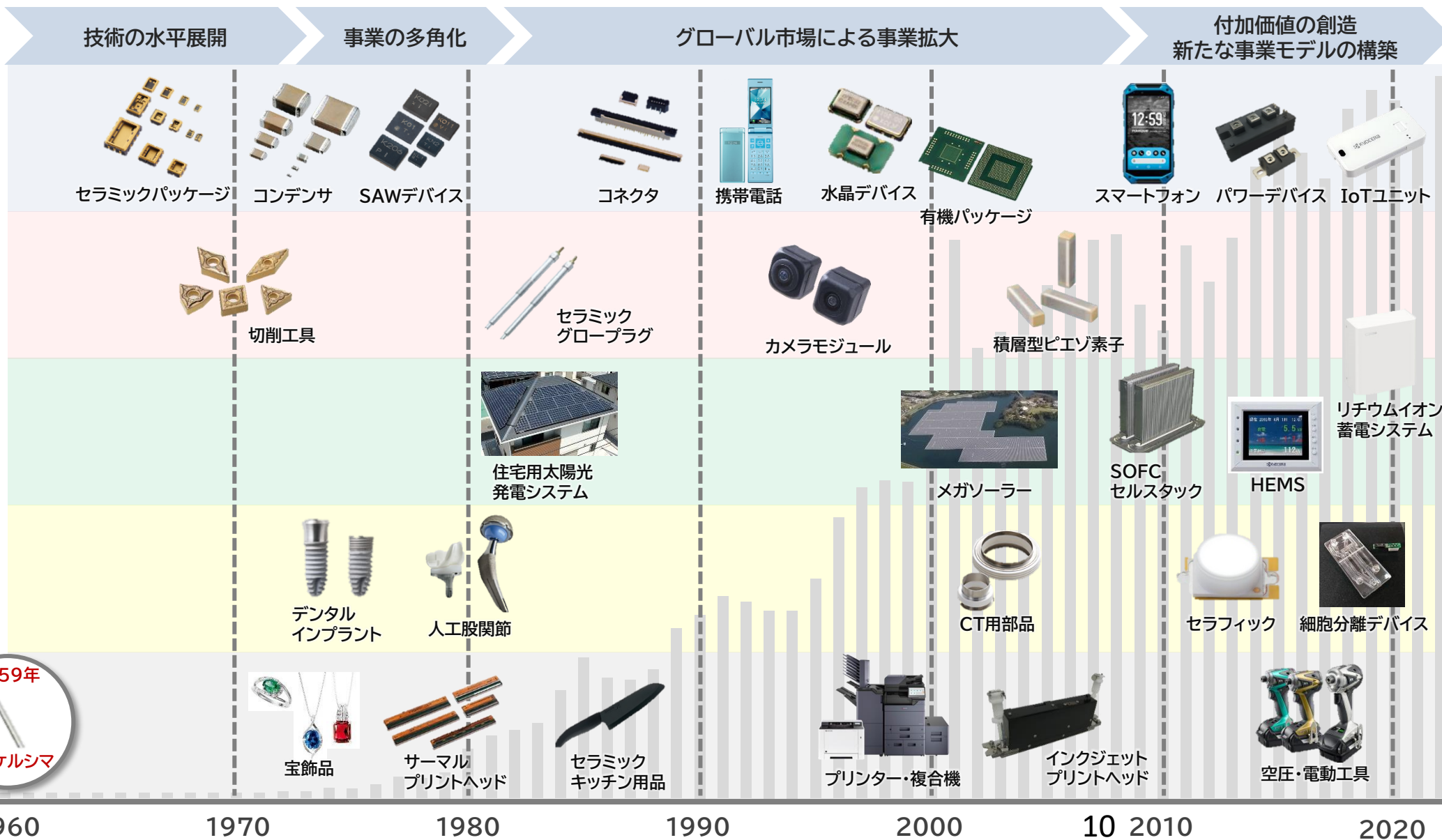
約**81,000**人



2023年3月期 海外売上比率

約**72%**

京セラの歩み ～一度も赤字を出さず、**挑戦**を続けてきました～



京セラの重点市場

A red decorative bar with a pointed left end, positioned below the main title.



注力する4つの重点市場





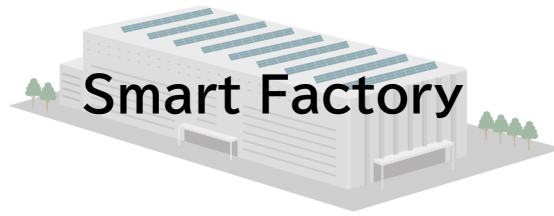
情報通信

ネットワークで
あらゆるものをつなぎ、
情報通信の未来を
創造しています。

5Gの特徴

- ①超高速
- ②超低遅延
- ③多数同時接続

活用例



Smart Factory



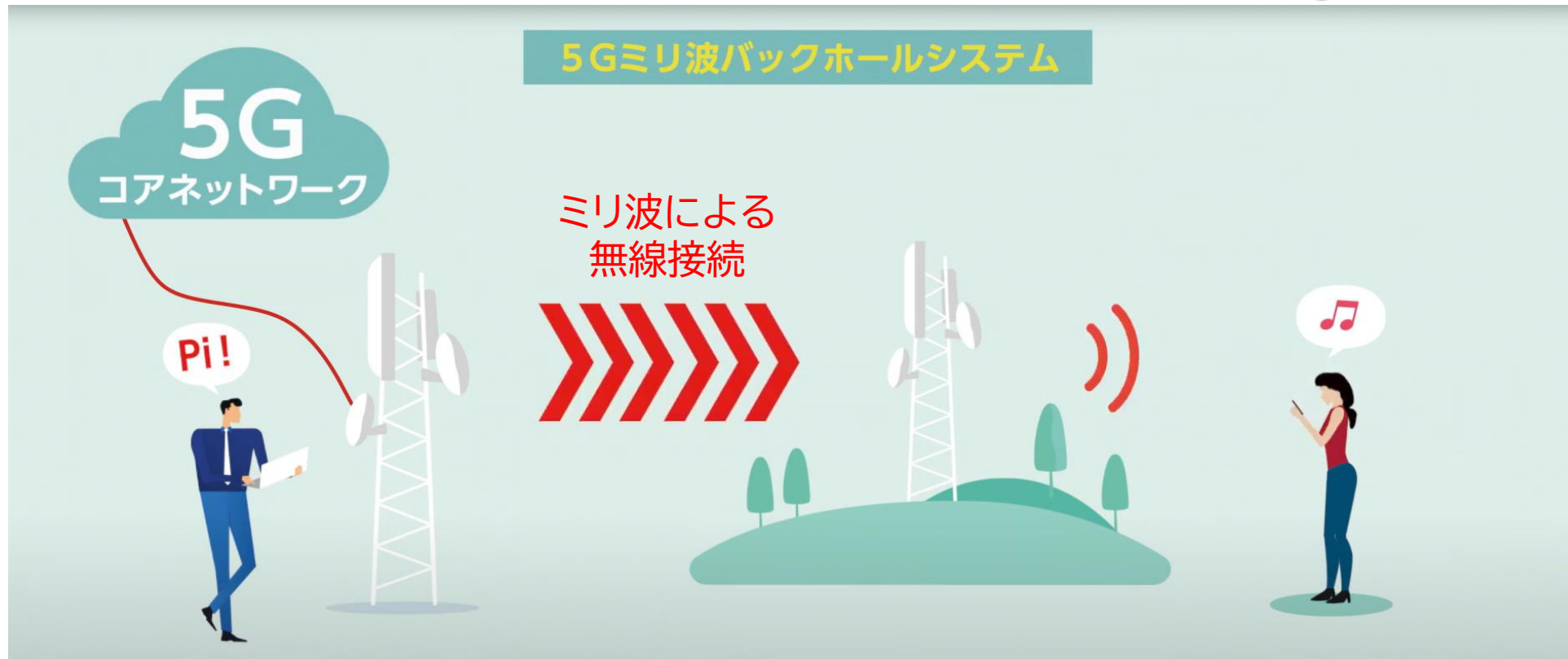
Smart Agriculture



Telemedicine



Self-driving



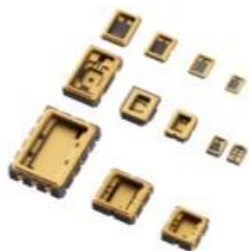
培ってきた無線通信技術をベースに 新製品展開・生産能力増強等による5G関連事業の拡大



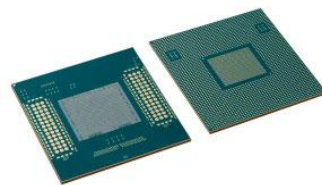
■電子部品／半導体関連部品



セラミック
コンデンサ



セラミック
パッケージ



有機パッケージ

■半導体・液晶製造装置用部品



半導体製造装置用

■スマートフォン



5G対応高耐久モデル(日本)



自動車関連

車載部品とインフラの
両面から安心で安全な
モビリティ社会の実現を
目指します。

全ての人がクリーンで自由・安全に移動できるモビリティ社会の実現

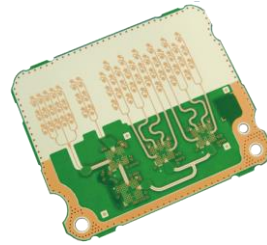


安全性向上や運転者の負担軽減を実現

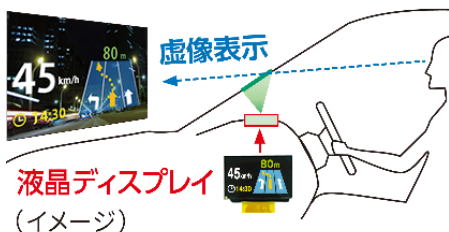
カメラモジュール



車載ミリ波レーダー用基板



ヘッドアップディスプレイ用
液晶ディスプレイ



車載向けコネクタ

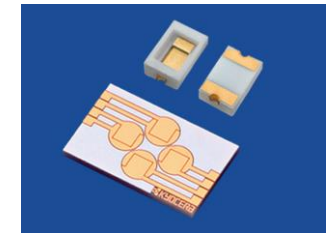


環境に優しく高性能な車載部品

酸素センサ用ヒーター



LED用パッケージ



EVリレー用部品

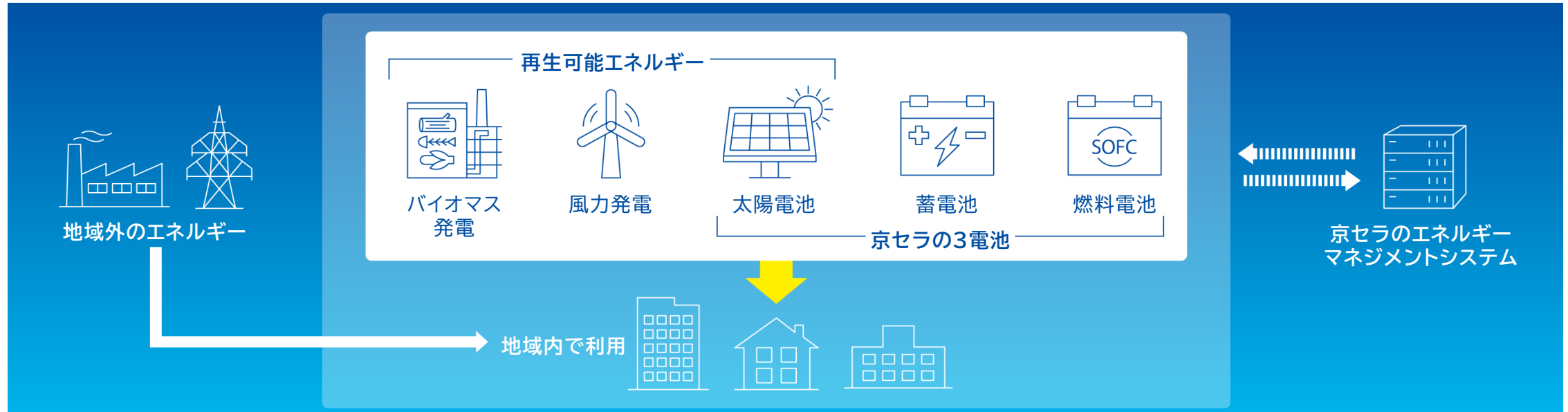




環境・エネルギー

地球に優しい
エネルギーを活用し、
持続可能な社会の実現に
取り組んでいます。

再生可能エネルギーと最適な電力制御で目指す脱炭素社会



クリーンエネルギーとして活用する京セラの3電池

太陽電池



蓄電池



燃料電池
(SOFC)



さまざまな分野で人と環境に優しい製品開発を推進

LED照明 CERAPHIC®

※「CERAPHIC」は
京セラ株式会社の登録商標です



デジタル捺染用 インクジェットプリントヘッド



◆ インクジェット印刷

—無駄が少なく、環境にやさしい—

- 短納期対応が可能 → **必要な時に、必要な分だけ生産**
- 製版が不要 → **廃液の削減 / 製版コストの削減**



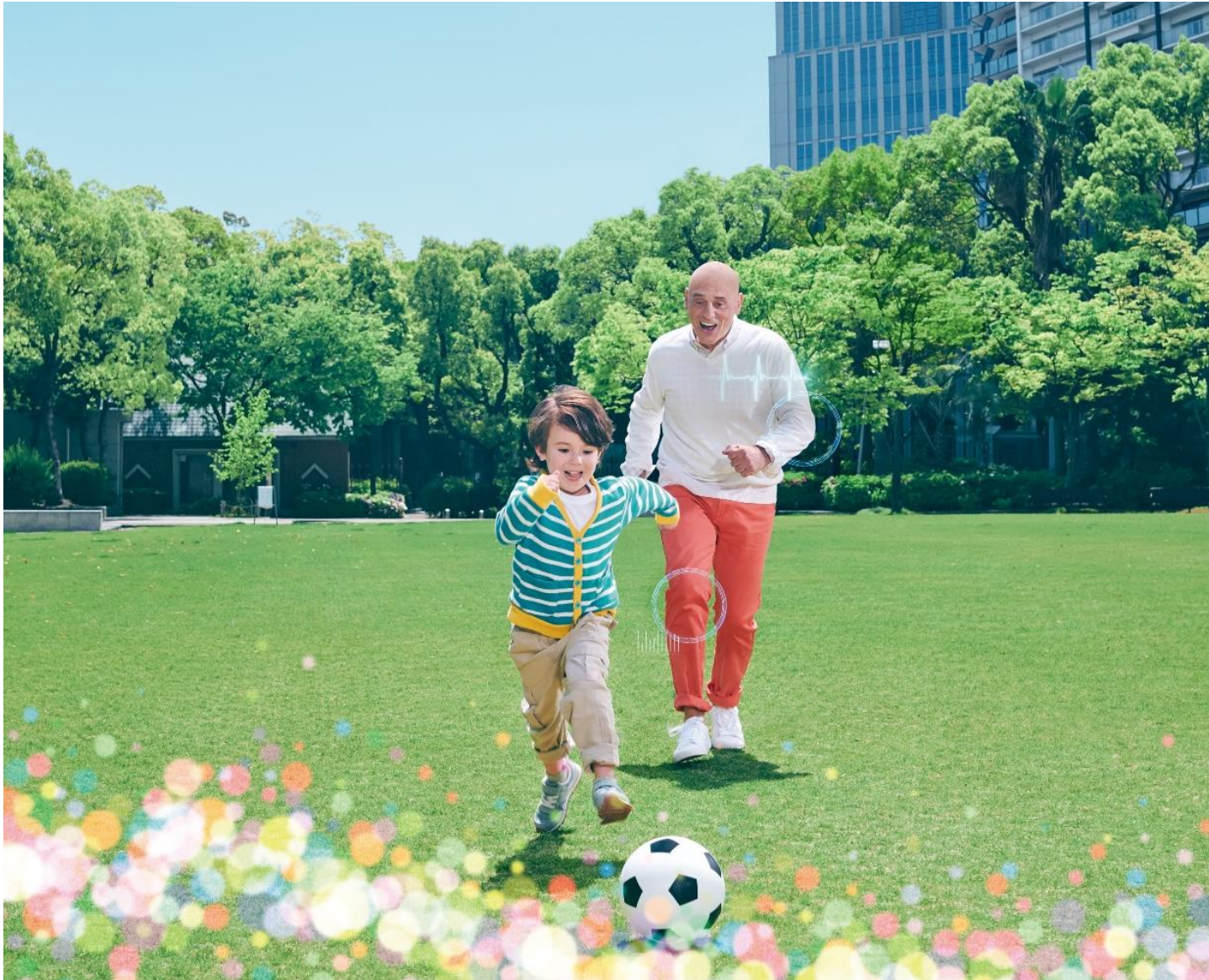
デジタル捺染の一例

◆ 既存の技術（アナログ印刷）

—無駄が多く、環境汚染につながる—

- 大量生産を前提 → **生産の無駄が多い**
- 製版洗浄で発生した廃液 → **環境汚染につながる**





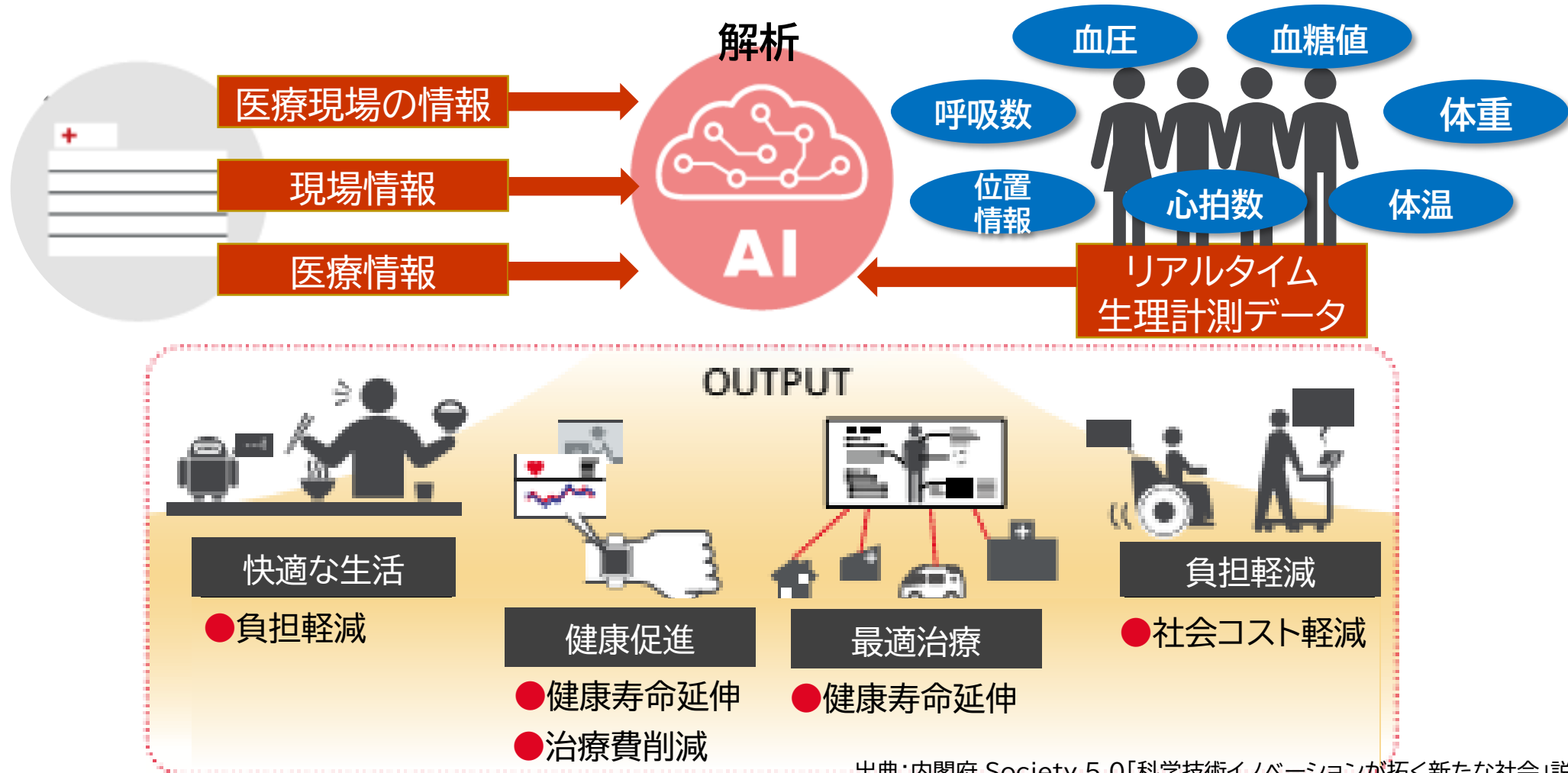
医療・ヘルスケア

先進技術の
研究開発を推進し、
医療のさらなる発展と
QOLの向上を目指しています。

デジタル医療で、医療の社会課題にアプローチ

医療の社会課題

①医療介護費の増大 ②労働力不足



QOL向上に貢献する製品開発や、医療の社会課題解決への取り組み

医療用製品の開発や再生医療分野への参入を推進

人工関節／デンタルインプラント

「Aquala®」



「BIOCERAM AZUL®」



「AG-PROTEX®」

※「Aquala」「BIOCERAM AZUL」「AG-PROTEX」は京セラ株式会社の登録商標です



デンタルインプラント

PRP調製キット

「Condensia®(コンデンシア)システム」



※「Condensia」は京セラ株式会社の登録商標です



「Aquala®」

- ・細胞膜と同じ分子構造を持つ「MPCポリマー」を使用
- ・耐用年数大幅延長が期待

令和2年度
第8回 技術経営・イノベーション大賞
科学技術と経済の会会長賞受賞

平成30年度
全国発明表彰
経済産業大臣賞受賞

平成24年度
日本ファインセラミックス協会
産業振興賞受賞

平成24年度
日本バイオマテリアル学会賞 技術賞受賞

平成23年度
第25回独創性を拓く先端技術大賞
経済産業大臣賞受賞

平成23年度
日本人工臓器学会技術賞受賞

福利厚生など

独身寮

✓エアコン・洗濯機・ベッド・マットレス・机・椅子・カーテン等貸与

✓寮費は月**4,000**円！

(水光熱費は別途必要)

✓入社から5年間or27歳まで

入寮可能

休日/休暇

✓年間休日**125**日

✓年末年始・GW・夏季に**長期連休**

✓有休年間**20**日付与 ※入社年は11日

➢年間平均取得日数**16.5**日

✓5日連続有休取得制度

➢取得率約**100**%！

➢土日とあわせて**9**連休も！

✓半日・時間単位で有休取得可能

育児・介護との両立

✓子供の1歳の誕生日の前日まで育休取得可

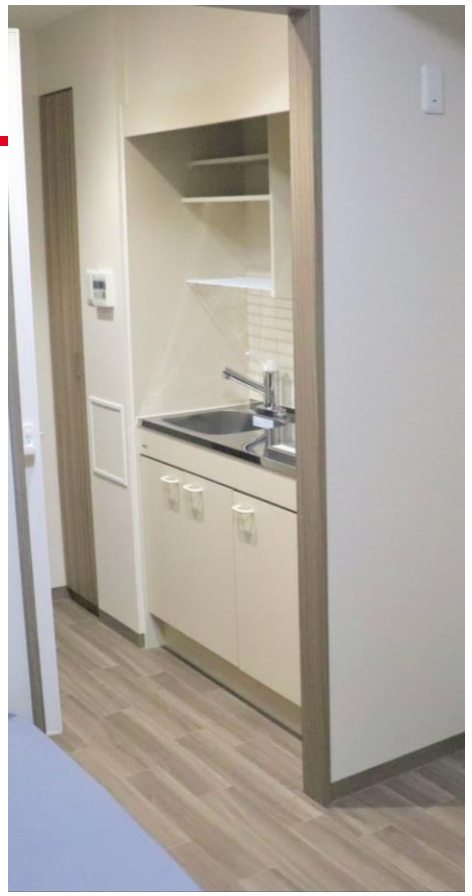
※事情により2歳に達するまで延長可

✓**男性育休取得者増加中！**

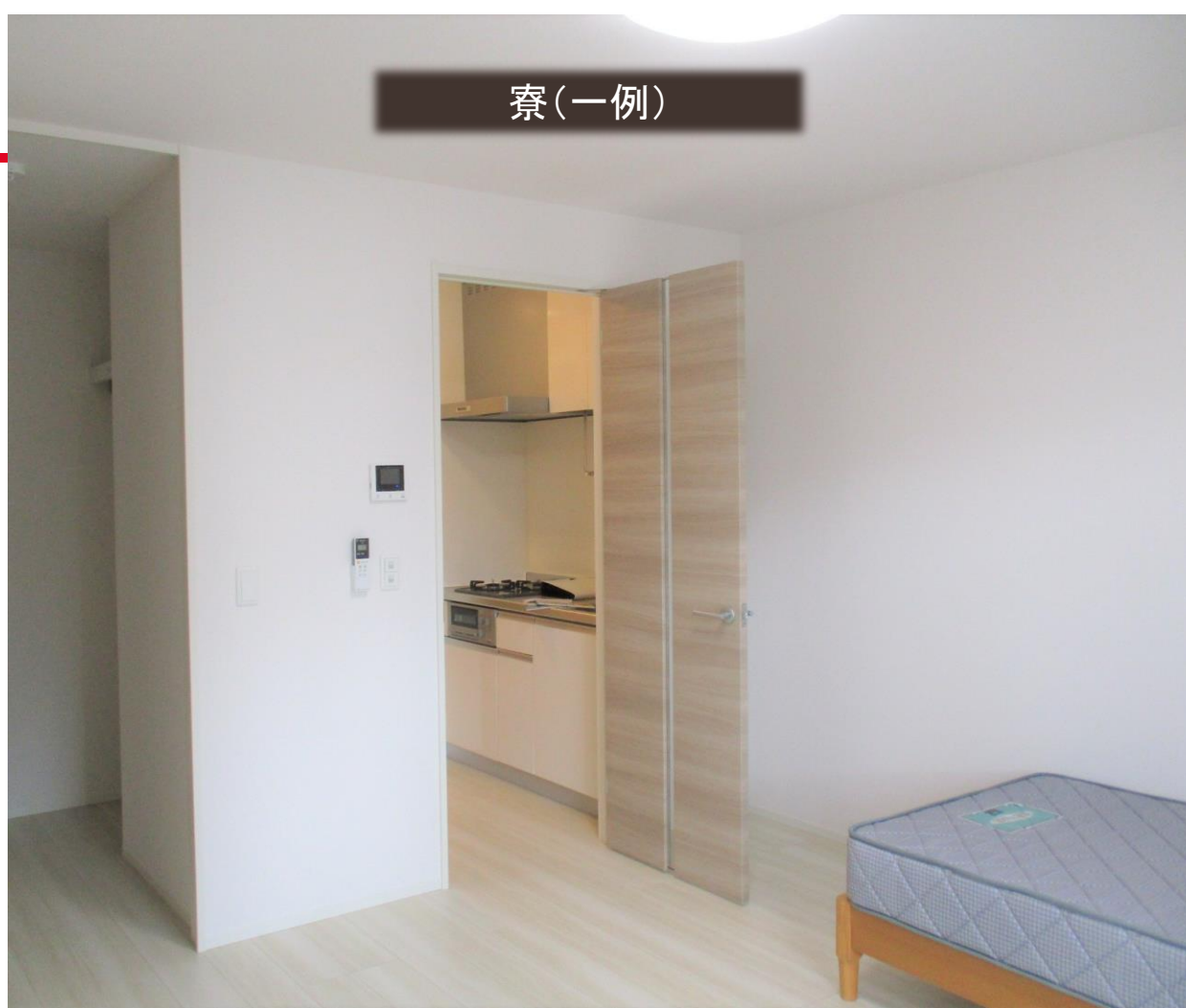
✓最大**2**時間の勤務時間短縮可

✓最大**1.5**時間の時差勤務可

従業員の物心両面の幸福を目指す＝福利厚生も充実！



寮（一例）



社内公募制度

自らの意思で仕事を
経験できる機会
を提供



チャレンジシステム

チャレンジを促進し、
ありたい姿を
後押し



充実の 研修メニュー

数多くの専門技術/
マネジメントスキル
研修を選んで受講



ベンチャー企業への 出向

新たな価値を生み
出す人材育成



キャリアを自ら切り拓いていく！

鹿児島島川内工場について

A red decorative bar with a pointed left end, positioned below the main title.



端っこの県 だけど…

九州新幹線の利用で、、、

鹿児島中央—川内

約11分

鹿児島中央—熊本

約43分

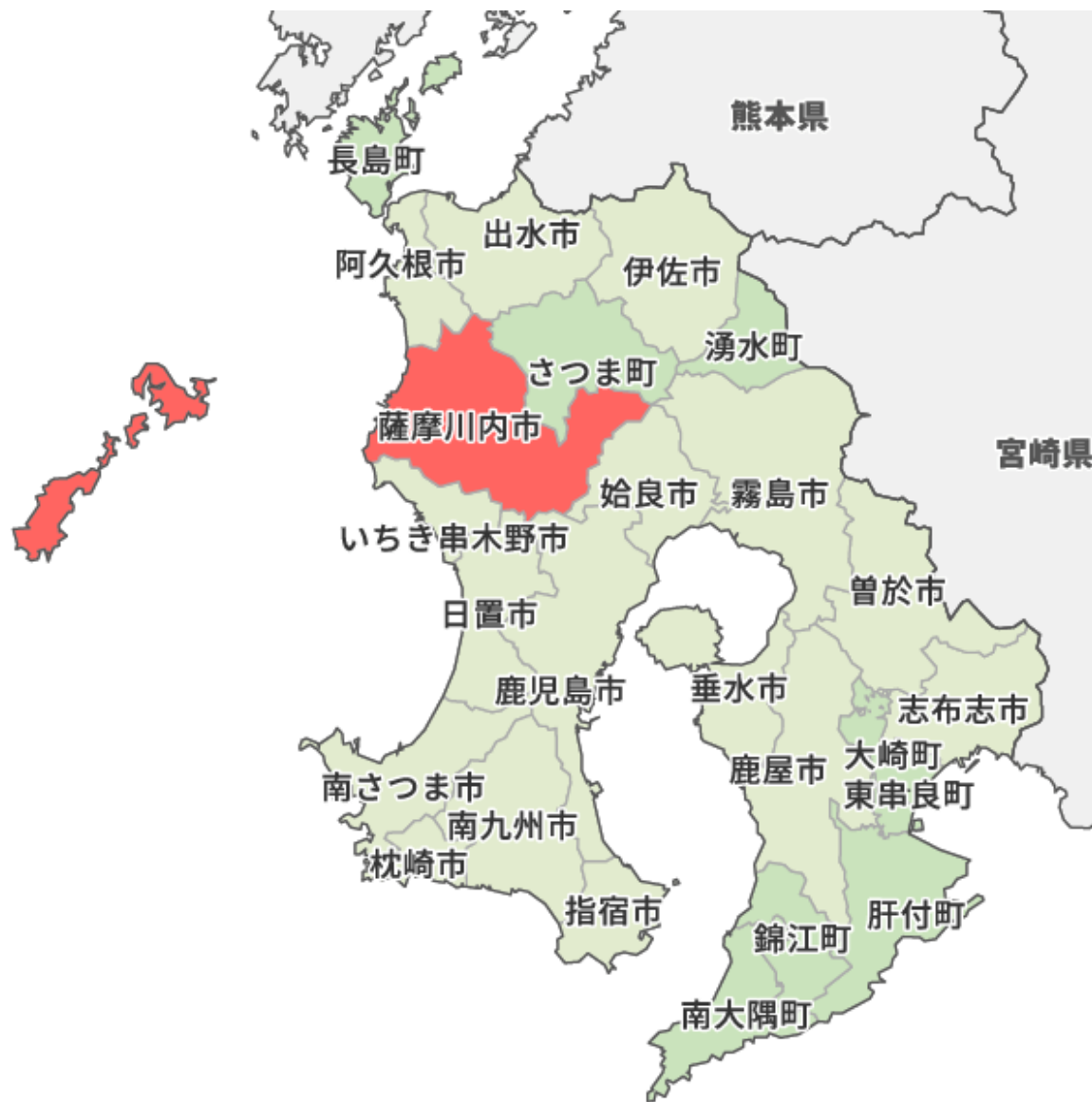
鹿児島中央—博多

約1時間16分

鹿児島中央—新大阪

約3時間46分

意外と近い！！
寝てたら着きます👏



☆鹿児島県ナンバーワンの面積！

☆中心を流れる川内川は九州で2番目の流域面積！

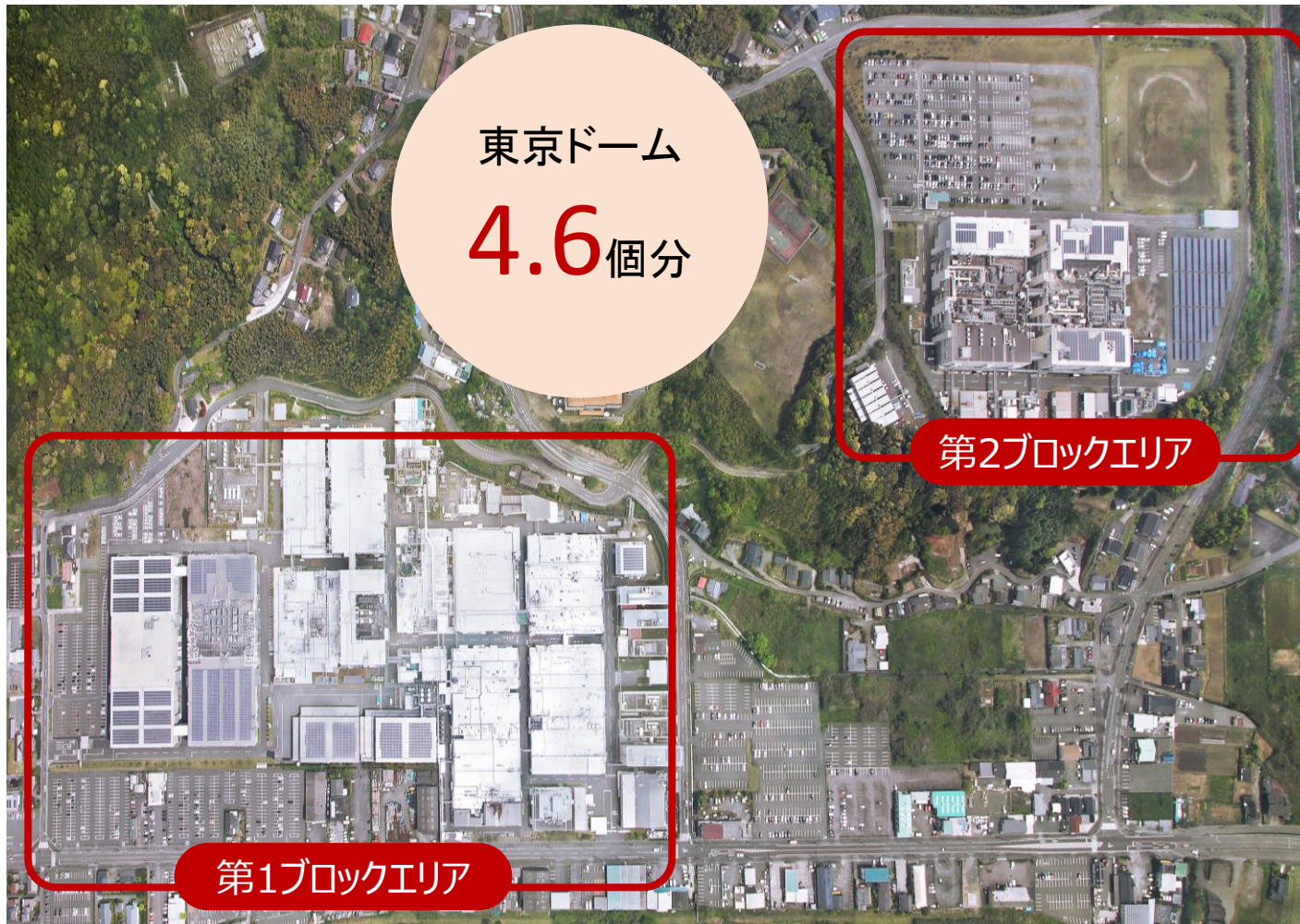
☆甕島という離島も薩摩川内市！

☆新幹線が停まるからアクセス◎！

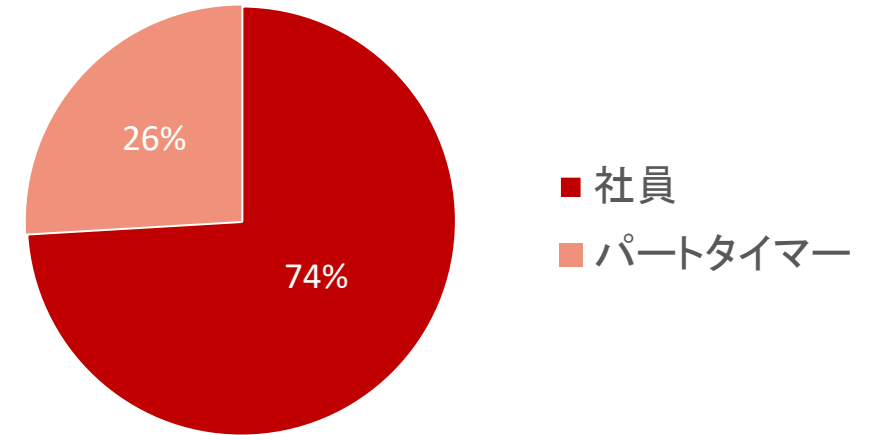
☆伝統的な行事を楽しめる！
大綱引きやはんや祭りなどなど…

☆川内特有の方言「～せん」「～だせん」
使い方 → ～だよね
例:〇〇ちゃんの職場って京セラだせん？

川内工場配置図



従業員数(年月現在)



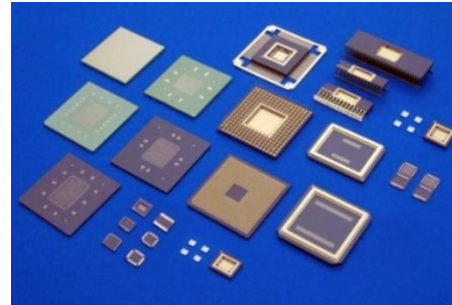
社員	3,847名
パートタイマー	1,155名
合計	5,002名

■ ファインセラミック部品

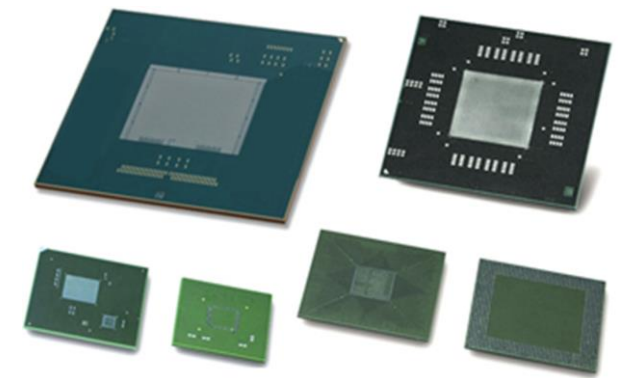


産業用機械部品

■ 半導体用セラミックパッケージ、有機パッケージ



セラミック多層パッケージ



情報通信市場向け有機多層パッケージ

■ 機械工具



工業用精密ナイフ



切削工具

■ セラミック応用商品

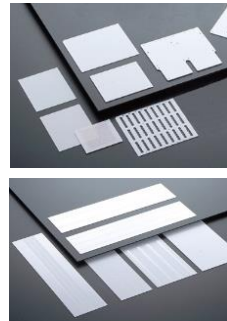


■ ファインセラミック部品

高純度に精製・合成された原料を用い、高度に制御された環境において高温で焼き上げることにより生まれるファインセラミックス。テレビのブラウン管に使用されるU字ケルシマ管から始まりその後、電気機器・デバイス用部品に代表される電子工業用部品や産業用機械部品、情報機器関連部品、装飾部品とセラミックスのもつ特性を活かし、その用途を拡げてきました。近年では薄肉で複雑形状の製作も可能とする独自製法の確立により、放熱構造部品など高冷却効率、省エネルギー面での新たな市場展開も図っております。



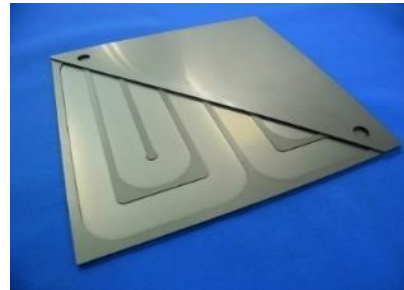
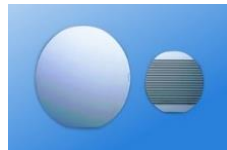
電子工業用部品



産業用機械部品



情報機器関連部品



放熱構造部品

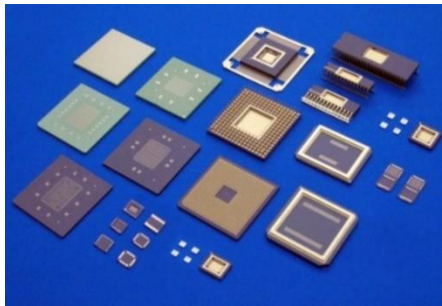


装飾部品

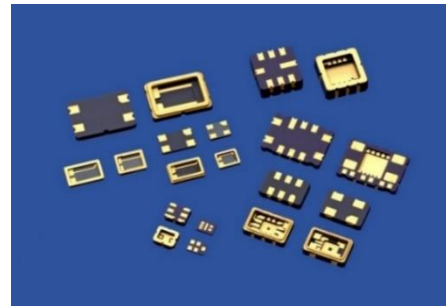
■ 半導体用セラミックパッケージ

多機能化、高性能化を続ける携帯電話、デジタル家電、情報機器、または自動車のエレクトロニクス化、学術研究の情報処理分野で、セラミックパッケージはICの発展に合わせて進化してきました。技術展開のキーポイントは多層セラミック技術といわれ、複数層のセラミックシートを積層することにより小型化、多ピン化、受動部品を内蔵することによる多機能化を実現しています。

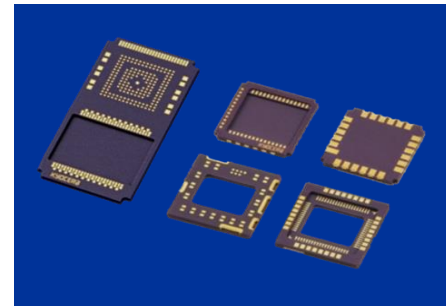
また、近年では水晶デバイスなどの電子部品用として、超小型化・中空封止構造が求められる為、壁厚を薄型化する高強度材料の開発、強度計算シミュレーション技術を駆使して開発を進めています。



セラミック多層パッケージ



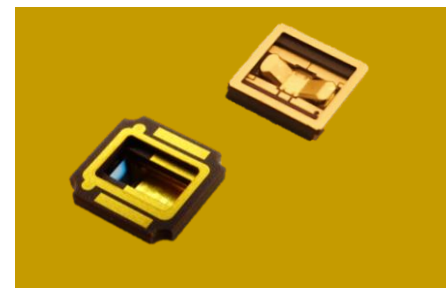
電子デバイス用表面実装
セラミックパッケージ



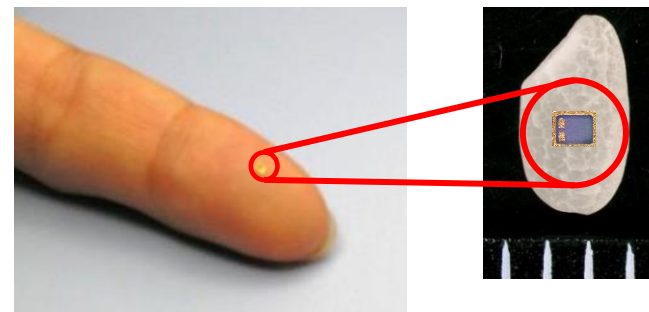
イメージセンサ用
セラミックパッケージ



CTスキャン PD用 実装用
セラミックパッケージ



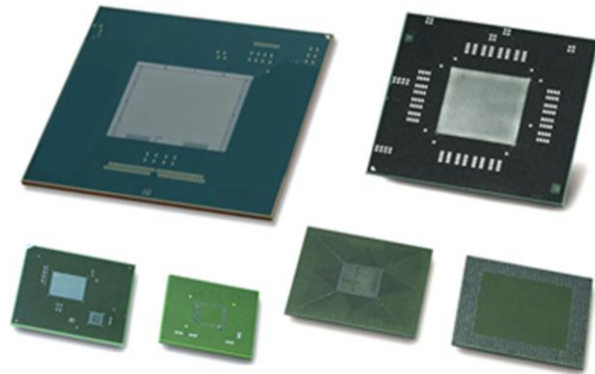
光源レーザ用
セラミックパッケージ



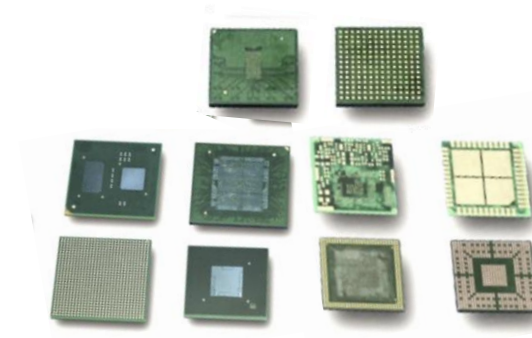
超小型SMDパッケージ(1.0×0.8mm)

■ 半導体用有機パッケージ

IoTの進展に伴う5Gネットワークの拡張、車載コンピューティング化に対して、ICチップの微細化、大型化が進み、そして高品質化が求められています。
有機パッケージはそのICチップの搭載基板として、最先端の微細化、多積層技術、そして高信頼性を追求した設計技術と品質管理技術にて、多くの製品を市場提供しています。



情報通信市場向け
有機多層パッケージ



車載ADAS市場向け
有機多層パッケージ

ADAS :
Advanced Driver Assistance System
先進運転支援システム
自動ブレーキ、衝突防止センサーなど
に関連する部品を示しております。

■ 機械工具

機械工具は、切削工具事業から空圧工具・電動工具事業まで、総合機械工具メーカーとして幅広い市場に対応しており、川内工場は、グローバルに展開する切削工具事業のマザープラントとして、『切削工具』『工業用ナイフ/耐熱・耐摩耗部品』の開発・製造をおこなっています。

耐摩耗性に優れる素材 ファインセラミックス、超硬合金、サーメットなどの材料開発とコーティング技術から生まれた独自の切削工具は、自動車産業、建設機械、造船業、航空機産業の金属加工の現場で重切削から精密加工まで、さまざまなプロセスで生産性向上に貢献しています。

■ 切削工具



工業用精密ナイフ



CVDコーティング



サーメット



MEV



MFSN88

回転工具



PVDコーティング



DLCコーティング



3AFK

ソリッドエンドミル



DRA

モジュラードリル

セラミック応用商品

ファインセラミックスは私たちの生活を楽しく快適にする生活用品のアイテムにも活かされています。耐摩耗性、耐食性に優れてるジルコニアセラミックスを刃に使用し、錆びず、切れ味が持続するキッチンナイフシリーズは軽くて使い易く、除菌漂白もできる為、清潔なイメージと好評を得ています。包丁としての強度と破壊靱性を兼ね備えた材料の開発、シミュレーション技術を活用して、欠け難い形状をデザインしています。



高専卒の先輩社員

A red decorative bar with a pointed left end and a tapered right end, positioned below the main title.

生産設備の自動化を進め、最先端のモノづくりに貢献しています！

— 半導体パッケージ エンジニア1年目(電気情報学専攻)

3Dモデルを使用し、お客様の要望に応えられる特注品設計を行っています！

— 切削工具設計者2年目(電気電子工学)

工場全体の新規生産設備導入に携わり、工場の発展を支えています！

— 生産設備エンジニア3年目(材料工学専攻)

学生時代の専攻を生かせる、様々な事業・職種があります！

DAY 1

- 8:00 始業ミーティング
- 9:00 メールチェック
- 10:00 作業状況の資料作成
- 11:00 工事スケジュール調整
- 12:00 お昼休憩
- 13:00 **新規設備構想**
- 15:00 明日の作業準備
- 16:45 勤務終了

先輩の声

PC上でホットを動かします。
とてもわくわくする瞬間です！
また、設備導入を考える際、**学生時代の専攻であった知識が活きていると**感じます。(材料工学専攻)

先輩の声

社内外の方と連携する業務が多く、**コミュニケーションの大切さ**を実感しています。
学生のうちから色々な人との関わりを大切に過ごしてほしいと思います。

DAY 2

- 8:00 始業ミーティング
- 9:00 メールチェック
- 10:00 製造現場へ移動し、
設備のメンテナンス
- 12:00 お昼休憩
- 13:00 **新規設備の引き渡し**
設備の使い方を展開
- 16:45 勤務終了

高専卒のキャリア例

A red decorative bar with a gradient, starting as a solid red bar on the left and tapering to a point on the right, positioned below the main title.

高専卒のキャリア例① 海外出向を経て責任者へ

◆プロフィール

性別: 男性

事業部: 宝飾品/キッチン用品など

高専時代の専攻: 機械工学

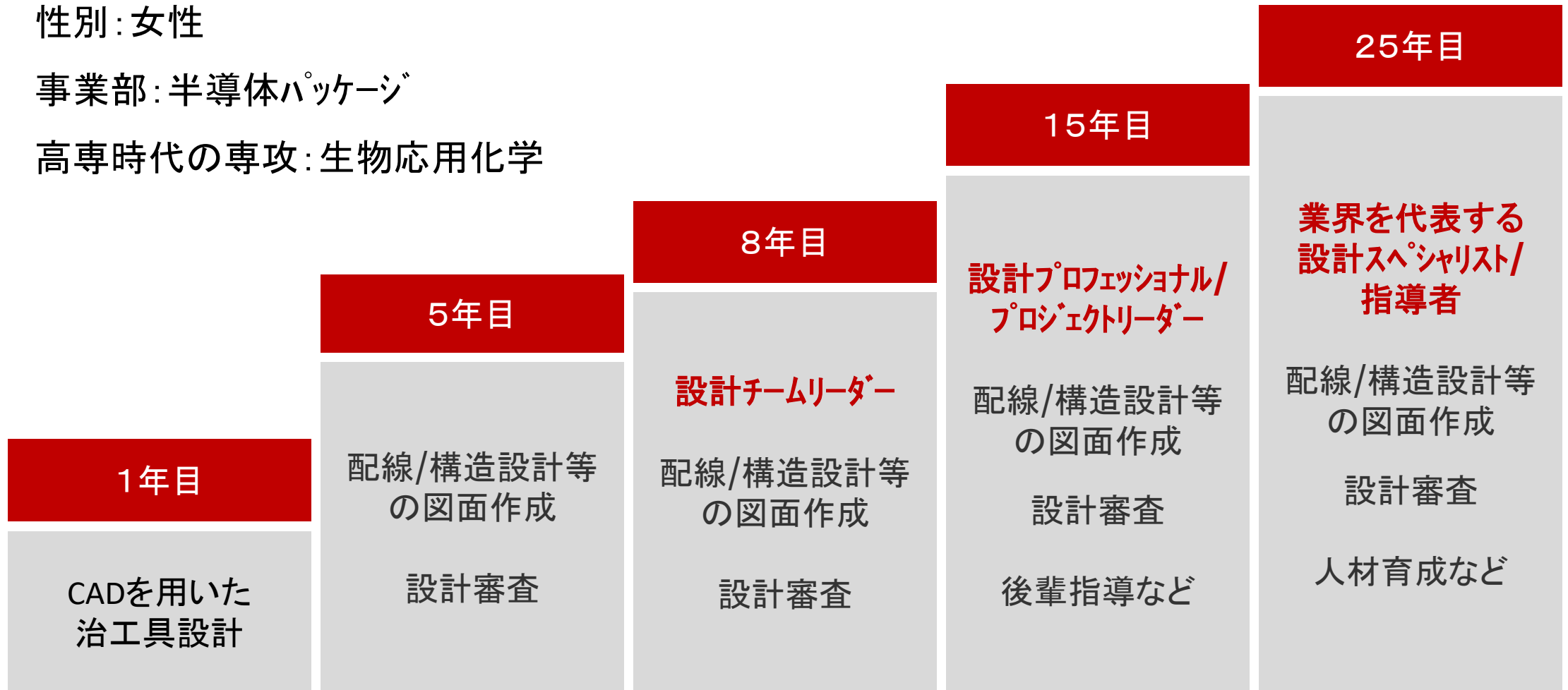


◆プロフィール

性別：女性

事業部：半導体パッケージ

高専時代の専攻：生物応用化学

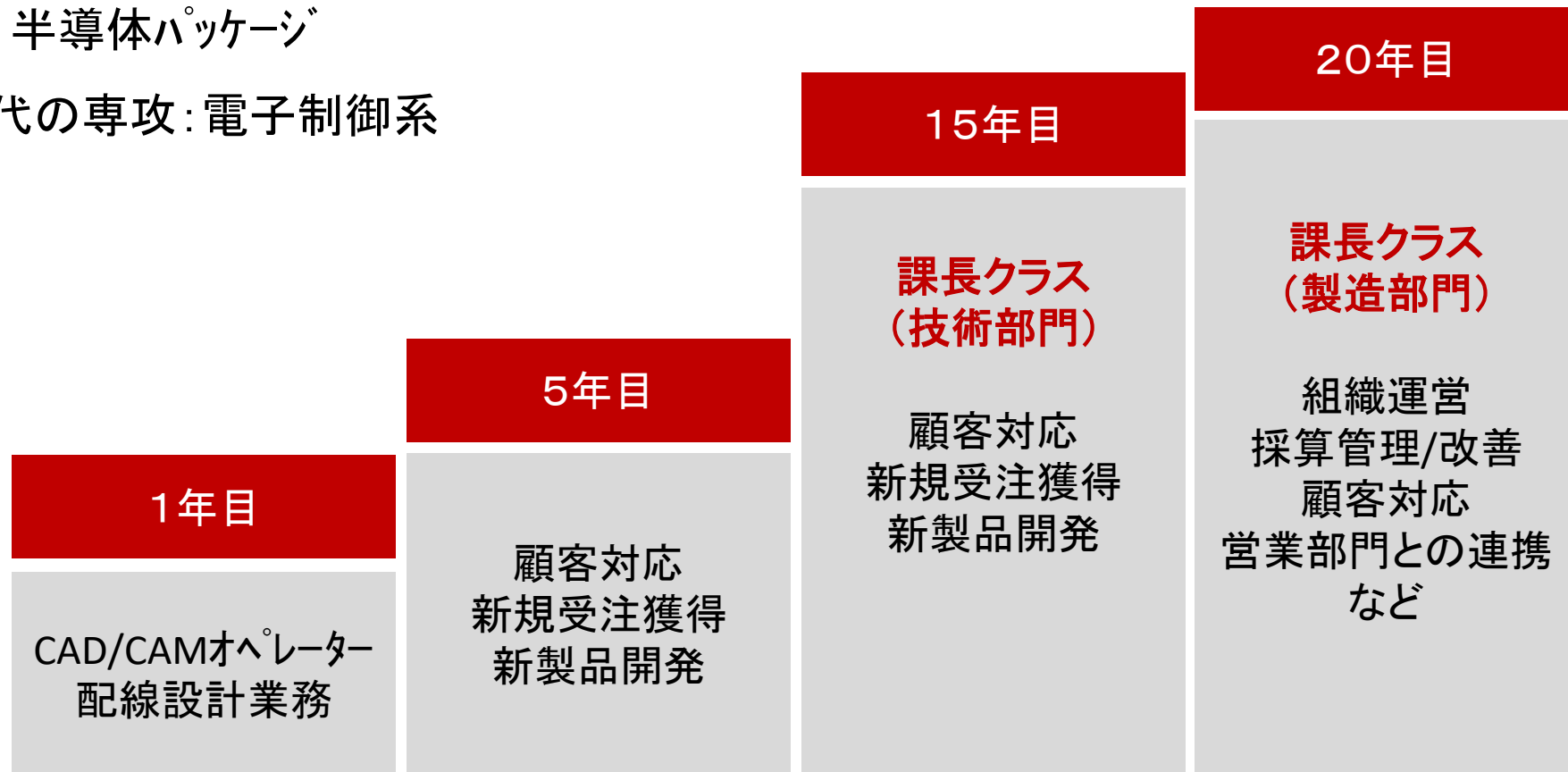


◆ プロフィール

性別：男性

事業部：半導体パッケージ

高専時代の専攻：電子制御系



選考情報

A red decorative bar with a pointed left end and a thin right end, positioned below the main title.

◆応募資格

2025年3月高等専門学校(本科)卒業予定の方

◆応募締切

随時受付しております。

初回締切は4月10日(水)です。

◆試験日時

初回締切分は4月23日(火)に実施します。以降、随時実施。

◆募集職種

次ページ

※詳細は求人票をご確認ください。

- ①セラミック部品の生産性改善、工程改善、設備構想・導入・改造を計画実行するエンジニア業務
- ②セラミックパッケージ製造の歩留り改善、製造仕様開発に携わるエンジニア業務
- ③セラミックパッケージ生産の設備改善、スマートファクトリー化推進を行うエンジニア業務
- ④セラミックパッケージの設計/加工条件書の作成等を行う管理技術業務
- ⑤工場内の生産システム維持/管理を行うエンジニア業務
- ⑥有機パッケージ製造における設備IoT設計・開発業務
- ⑦有機パッケージ製品における品質システムの構築・監視・改善業務
- ⑧機械工具製品における生産システムの構築と運用メンテナンス業務
- ⑨機械工具の製品製造にかかわる品質改善、設備立上げ、新製品仕様確立業務
- ⑩機械工具製品設計全般
- ⑪工場内の製造プロセスの採算/生産性調査、改善、新ライン構想/構築などインダストリアルエンジニア業務
- ⑫各種事業の生産設備の制御プログラム設計、開発業務

皆様のご応募をお待ちしております！

A red graphic element resembling a wide arrow pointing to the right, positioned below the main text.